

2026 年度 “提质增效重回报” 行动方案



华润微电子有限公司

China Resources Microelectronics Limited

华润微电子有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的信心、对内在价值的认可以及履行社会责任的实际行动，公司制定《华润微电子有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。本方案在回顾 2025 年各项举措实施成效的基础上，明确 2026 年重点行动方向，旨在进一步提升经营效率、增强市场竞争力、保障投资者权益，持续巩固良好的资本市场形象。具体内容如下：

一、坚持 IDM 商业模式，以高质量发展铸就价值投资基础

2025 年，全球半导体市场在人工智能、高性能计算及数据中心建设的拉动下步入周期性增长通道，功率半导体景气度显著回升。报告期内，公司积极开拓市场、优化产品结构，产能利用率保持高位。全年实现营业总收入 110.54 亿元，同比增长 9.24%，其中第四季度营收 29.85 亿元，创历史新高。受重庆、深圳 12 吋产线等重大资产投资折旧影响，实现归母净利润 6.61 亿元，同比下降 13.37%。经营性现金流保持稳健，为后续高质量发展积蓄动能。

进入 2026 年，AI 应用对终端需求的拉动效应持续显现，公司紧抓新兴领域发展机遇，客户拉货节奏明显加快，6、8 吋及重庆 12 吋产线持续满载运行，深圳 12 吋产线处于产能快速爬坡阶段。公司已于 2026 年 2 月正式发布产品涨价函，同时将持续通过动态调整产能与产品结构，为业绩高质量增长聚势赋能。重点项目进展情况如下：

1. 参股的重庆 12 吋功率半导体晶圆生产线项目

2025 年公司充分发挥产线技术优势和规模效应，加快中低压

MOSFET、高压 MOSFET 和 IGBT 高端产品开发与产业化进程，提前一年半达成月产 3 万片的目标，并成功拓展 AI 算力、机器人、低空经济等新兴领域，进一步巩固国内功率半导体行业的领先地位。

2026 年公司将进一步聚焦新能源、工控、AI 算力、汽车电子等高端场景，形成国内领先的车规级功率半导体平台，力争全年保持较高的产能利用率，并按照投资计划稳步推进产能扩充。

2. 参股的深圳 12 吋集成电路生产线项目

2025 年深圳 12 吋产线正式进入爬坡期，同步推进 90nm、55nm、40nm 三大技术节点。公司加快产品线开发与市场渠道建设，年底实现月产能 1.5 万片；同时聚焦大客户策略，多个核心项目取得突破，为业务长远发展夯实基础。

2026 年公司将着力突破 55-40nm 以上 BCD、HV、RF、Flash 等模拟特色工艺，重点聚焦 MCU、电源管理、Driver、逻辑运算、存储、RF 射频等产品，加速推进客户产品导入验证工作，至 2026 年末产线产能将爬坡超 3 万片/月，并同步开展下一技术节点的工艺研发工作。

3. 先进功率封测基地项目

2025 年先进功率封测基地产能持续释放，其中 IPM 模块封装实现了大规模量产。产品结构同步优化，汽车电子及工业控制领域占比突破 70%，有力支撑公司在高附加值市场的渗透布局。

2026 年公司将持续推动封测基地全面覆盖功率半导体产品模块封装、晶圆中道生产线、面板级封装、第三代半导体封装等技术领先门类，加快模块、功率器件新品开发及上量，稳定生产工艺，进一步增加模块产出及产值。

4. 高端掩模项目

2025年，掩模业务营收同比增长40%。技术研发方面，90nm节点客户验证稳步推进，40nm节点实现研发量产。高端掩模新线产能利用率超90%，新品良率稳定在98%以上，准时交付率接近100%。

2026年公司核心任务聚焦实现40nm节点量产导入，并推动下一技术节点的研发取得关键进展。公司将集中掩模业务的研发资源，优先攻克高端制程CD控制等核心工艺难题，完善产研销协同机制，精准响应客户需求，加速研发成果市场化转化。

二、加快发展新质生产力，聚焦技术和产品创新

公司以市场需求为导向，持续强化核心技术攻关与自主创新能力，推动研发成果向经营绩效高效转化。

1. 推动研发投入稳步增长

作为科技创新型企业，公司坚持“前瞻布局+中短期攻坚”的协同创新模式，聚焦解决业务痛点，加速可落地项目转化。报告期内，公司研发投入达11.68亿元，研发投入占比10.57%，逐年保持高强度研发。同时持续完善专利布局，截至2025年末，累计获得授权并维持有效的专利共计2,547项，较上年末增加195项，其中发明专利2,187项，占专利总数的85.87%，核心技术护城河不断夯实。

公司积极服务国家战略，承接多项国家与地方科技重大专项项目。目前，1项国家重大专项、4项国家重点研发计划、2项长三角科技创新共同体联合攻关任务、2项省级重点研发计划、3项省级技术创新专项及3项部委级专项均按计划有序推进。同时，公司坚持自主创新与开放协同并重的研发理念，通过自主建设研发机构与深化产学研用合作，最大化整合外部资源。截至报告期末，已建成重点/联合实验室9个、研发创新联合体5个、国家级研发机构1个、省级技术研

发平台 10 个、市级技术研发平台 12 个，研发体系日趋完善。

2026 年，公司将持续保持 10%左右的研发投入占比，同步优化研发团队结构，推动专利申请及获授权数量稳步增长。研发工作紧密围绕“强产品、绑客户、降成本、提效能”展开，在资源保障基础上贯通业务全流程，强化战略与市场牵引，以系统化的产品规划承接公司战略，为公司高质量发展提供坚实支撑。

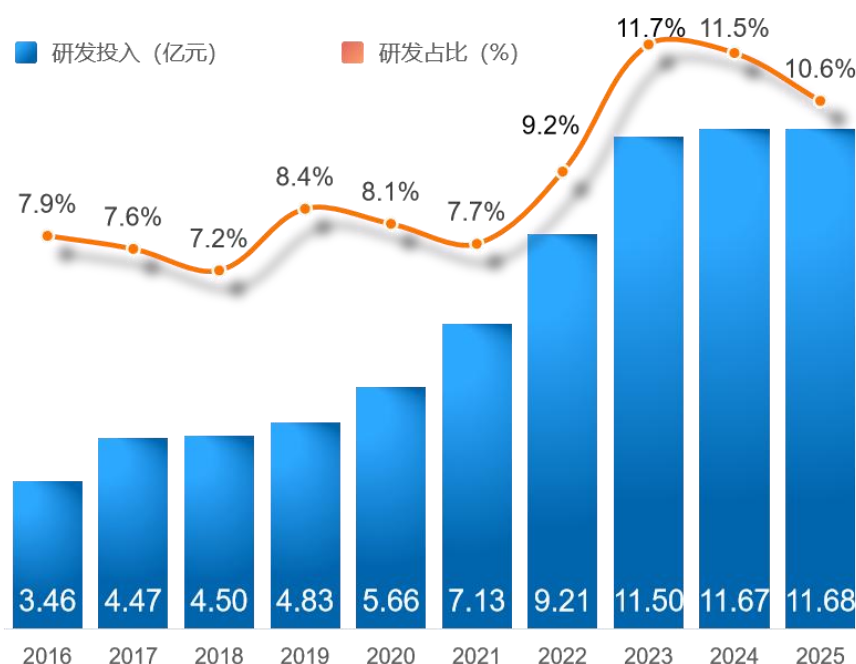


图 1：公司历年研发投入情况

2. 加速产品技术迭代

公司依托全产业链布局与深厚的工艺制造积淀，持续巩固在国内功率半导体行业的领先地位，技术竞争力领跑本土同行。各核心产品线进展如下：

MOSFET 产品：核心品类实现显著增长，车规级 MOS 产品已形成全场景覆盖，并成功拓展 AI 算力、机器人、低空经济等新兴领域。

IGBT 产品：在工业（含光储）、汽车领域销售占比超过 70%，基于 12 吋研发的新一代 G7 平台顺利落地，产品性能达到国际一流水平。

第三代宽禁带半导体：碳化硅已形成 650V/750V/1200V 系列化产品矩阵，车规模块产品批量供应，营收实现翻倍以上增长。氮化镓面向工控大功率电源、数字服务器电源开发系列化产品，关键技术与客户突破成效显著。

功率模块：已形成 TMBS/IGBT/SiC/IPM/MOSFET 模块等多品类协同发展格局，销售规模快速增长，在头部客户实现批量交付。

功率 IC、智能传感器及智能控制产品：车规领域成果突出，多颗车规级芯片通过 AEC-Q100 车规考核认证；车载超声波雷达驱动及信号处理芯片 CS7209 荣获《2025 中国创新 IC-潜力新秀奖》等。

2026 年，公司将以应用场景为牵引，强化内部协同，打造优势 IDM 能力。重点推进三大方向：

一是依托 6/8/12 吋晶圆线与封测线的垂直整合制造体系，通过晶圆工艺升级与模块性能提升，以定制化模块抢占高价值赛道，持续提升功率模块市占率与车规级产品占比。

二是推动功率器件与功率 IC 融合发展，组建“技术+市场”联合团队，提前介入客户产品研发环节，通过技术协同与场景绑定，逐步构建“器件—模块—方案—服务”的全方案能力，实现从单器件供应商向系统级解决方案商的跨越。

三是统筹推进传感器设计、制造、封装全链业务，以“应用场景需求”为起点，打通“需求—应用—研发—量产—交付”闭环，明确核心技术路线、产能规模目标与市场优先级。

3. 推动下游应用向高端转型

在产品与方案板块，公司各领域营收均实现同比增长。泛新能源领域作为业务基本盘及重点战略方向，增长表现突出：光储领域受益

于“算电协同”加速落地，出货量同比大幅增长；汽车电动化与智能化持续深入，公司车载功率器件及控制芯片已广泛应用于车身、智能驾驶、底盘及动力系统等整车场景，单车配套价值量稳步提升。



图 2： 2025 年公司产品与方案板块下游终端应用情况

2026 年，公司将在深化白电、汽车电子、风光储、工业领域产品竞争力、提升市占率筑牢基本盘的基础上，通过资源倾斜、技术攻坚与组织适配优化布局，持续提升汽车电子占比，重点聚焦数据中心、机器人、无人机等领域。同时，围绕人工智能“感知—传输—决策—执行”全链路，以硅基半导体、第三代宽禁带半导体、传感器和光芯片三条核心曲线为战略支点，全面布局 AI 全场景业务，为 AIoT 全链路技术架构筑牢底层支撑。

三、以奋斗者为本，重塑组织激活动能

公司始终将人才视为高质量发展的核心资源。截至报告期末，公司共有研发技术人员 4,814 名，占员工总数比例为 41.41%，人才密度持续提升。核心技术人员均在半导体领域深耕数十年，具备丰富的研发经验与前瞻性的创新能力，为公司产品迭代紧跟行业趋势、满足

客户终端创新需求提供了坚实的人才保障。

2025年，在坚实的人才基础上，公司持续深化分配制度改革，锚定“创新+业绩”双目标，通过工资总额管理、创新专项保障激发短期活力，以多元化股权激励构建长期利益共同体。公司建立健全激励与约束并重、效率与公平兼顾、符合市场规律又体现央企特色的分配机制，优化董事及高级管理人员薪酬体系。对高精尖科技领军人才实施“一人一议”协议薪酬，并针对性推出战新人才薪酬倾斜、销售激励优化、项目里程碑激励等精准举措。2025年3月，公司完成股权激励首次授予部分第二次解锁及预留授予部分第一次解锁，合计1,386名激励对象实际归属401.24万股第二类限制性股票，实现短期激励与长期发展的有效协同。

继2026年3月顺利完成股权激励预留授予部分第二期解锁工作后，2026年公司将持续优化薪酬体系，强化薪酬与经营业绩、市值表现的挂钩机制，完善业绩考核指标体系。同时，开展“AI+人才”专项培养计划，打造专业数字化队伍，为公司长远发展积蓄人才动能。

四、以投资者为本，与投资者共享发展成果

公司始终坚持稳定、持续的现金分红政策。自2020年上市六年以来，每年稳定现金分红，累计分红约8.85亿元，切实履行长期价值共享承诺。2025年面对四大重点项目等资本开支的巨大压力，公司仍坚持连续分红，并首次实施中期分红，分别于2025年6月、10月完成2024年度及2025年半年度现金分红，为股东提供及时回报。

2026年4月，董事会审议通过2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划，拟将2025年度总体派息率提升至15%，并在符合分红条件且不影响正常经营的前提下实施2026年中期现金分红。

五、完善公司治理，以卓越董事会实现高效管理

1. 秉持“高标准、严要求”规范并实现高质量信息披露

2025年，公司严格遵守监管要求，共披露公告文件75份，合计约120万字，持续提升信息披露的深度、广度与时效性。自2022年上交所科创板开展信息披露评价以来，公司2022至2025年连续三年获评“A”级。

2026年，公司将继续严格依据相关法律法规以及公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》(以下简称“公司《章程》”)和《华润微电子有限公司信息披露事务管理制度》等规章制度，高质量履行信息披露义务。

2. 完善公司治理制度

2025年，公司审议通过了修订后的《华润微电子有限公司组织章程细则》《华润微电子有限公司股东会议事规则》《华润微电子有限公司董事会议事规则》《华润微电子有限公司对外投资管理制度》等十余项治理制度，新增《华润微电子有限公司市值管理制度》，并动态优化《华润微电子有限公司董事会授权决策事项清单》，进一步明确授权范围与决策流程。同步完成决策事项清单与权责运行手册修订，持续夯实治理基础。

2026年，公司将对齐相关法律法规的最新要求，根据公司《章程》、决策事项清单与权责运行手册及自身实际经营需要，进行合理授权与决策，持续完善公司治理有关制度及管理流程。

3. 强化外部董事和独立董事履职

公司积极为董事履职创造良好条件。2025年，外部董事平均履职120天（现场31天）；换届前独立董事平均履职35天（现场12

天)；现任独立董事自 2025 年 5 月起平均履职 66 天(现场 17 天)。公司组织董事参与股东会、董事会及各专门委员会会议，提前沟通重要议题；邀请董事出席战略经营会、业绩说明会、战略中期检讨会等关键会议；安排下属单位调研及管理层座谈，为董事会科学决策提供专业支撑。

2026 年，公司将持续巩固董事履职保障的良好实践，在常态化信息推送、专题调研及战略研讨基础上，进一步优化决策支持流程与沟通反馈机制，确保外部董事与独立董事深度参与重大经营管理决策，高效履行各项职权。

4. 持续落实经理层向董事会报告机制

2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议，公司董事长代行总裁职责作《华润微电子有限公司 2024 年年度总裁工作报告》，并向董事会报告了董事会授权决策事项的行权情况；2025 年 5 月公司顺利完成董事会换届，保障治理机制平稳过渡与战略连续性。2025 年 8 月 27 日第三届董事会第三次会议，公司董事长作《华润微电子有限公司 2025 年半年度总裁工作报告》，同步报告上半年董事会授权董事长决策事项行权情况。

2026 年，公司将持续强化董事会战略督导与经理层执行效能的双向协同，建立落实经理层向董事会定期汇报的机制。

六、价值引领，共筑市值新篇章

公司深化投资者关系管理，系统开展多层次、多渠道沟通交流，强化预期引导，优化股东结构，扎实推进市值管理。

1. 引导长期投资，优化股东结构

公司全年组织投资者交流活动 154 场，覆盖海内外投资者及分析

师超过 1300 人次。通过策略会、线上交流、路演及现场调研等多种形式，持续拓展沟通覆盖面，重点加强与核心投资者、长期资金及专业研究机构的常态化交流，深化市场对公司战略与长期价值的理解。

2. 畅通多元渠道，构建透明、高效、互信的沟通机制

公司高质量举办业绩说明会，邀请董事长、董事会秘书及独立董事出席，围绕战略布局、经营成果、行业展望及市场关切事项进行充分沟通。同时充分利用股东会、上证 e 互动平台、投资者邮箱、热线电话等渠道保持密切沟通，并通过图文、视频等方式提升公告可读性与针对性。

3. 打造品牌化开放日，强化资本市场连接

公司将投资者开放日暨新品发布会打造为年度品牌活动。2025 年 11 月于深圳成功举办“润芯无界，智见未来”开放日，邀请投资者、分析师、合作伙伴及媒体近两百人参与，通过实地参观、战略分享、新品发布及交流问答，全面展示公司技术创新与产业链协同能力。

4. 系统推进市值管理，夯实价值实现基础

2025 年 4 月《华润微电子有限公司市值管理制度》正式颁布实施，推动公司市值管理工作进一步制度化、规范化。公司对相关指标实施动态监测与跟踪管理，深入开展市值管理专题研究，对标行业优秀实践，探索多元化市值管理工具，促进价值创造、价值传播与价值实现协同提升。

2026 年，公司将继续完善投资者的管理体系，促进公司价值传播与市值管理的协同提升。公司将依托上证路演中心、进门财经等专业平台，全年举办不少于 4 场业绩说明会，确保重大经营节点及时、充分传递。同时加强与投资者的线下互动，公司将积极参与上交所“我

是股东”等主题活动，持续举办投资者开放日，邀请投资者实地参观调研。此外，公司将充分运用官网及“华润微电子芯闻号”微信公众号等自有渠道，构建多层次、立体化的信息传播矩阵，确保投资者能够便捷、及时、全面地获取公司经营动态与发展战略，增进对公司投资价值的理解与认同。

七、全面贯彻“ESG”理念，坚定执行“双碳”战略

公司高度重视 ESG 对长期价值创造的驱动作用，坚定响应并积极践行国家“双碳”战略，以责任治理与绿色转型引领企业高质量发展。

1. 健全治理体系，升级双碳管理

公司持续完善 ESG 环境管理体系，制定《华润微电子有限公司双碳管理制度》及配套考评机制，将碳减排目标纳入经营考核，推动低碳治理制度化运行。2025 年首次完成公司及子公司全口径碳盘查，全面覆盖范围一、二、三温室气体排放，并针对各下属单位产业特征制定“一企一策”降碳实施方案，实现碳核算、目标管控、项目执行与数据跟踪的统筹推进。此外，公司积极优化能源结构，在采购绿电基础上，加快分布式光伏、储能等清洁能源的规模化应用，助力能源供给清洁化、低碳化转型。

2. 对标披露要求，提升披露质量

公司严格参照上交所指引，高标准开展 ESG 管理与报告编制，已连续 13 年发布可持续发展报告。报告期内，公司率先采用双重重要性评估框架，兼顾财务重要性与环境社会影响，运用治理、战略、风险管理、指标与目标“四支柱”披露模型，突出“应对气候变化”“可持续供应链”“研发创新”等关键议题，并首次对年度可持续发展报告实施独立鉴证，显著提升披露内容和数据的准确性与公信力，形成规范、完整、

可追溯的 ESG 披露体系。

3. 塑造特色品牌，践行责任担当

2025 年，公司在总结“十四五”ESG 工作成效基础上，面向“十五五”谋篇布局，以“SPRING 芯芯向荣”品牌为引领，构建绿色低碳、以人为本、和谐共生、科技创新、携手共赢、暖芯行动六大行动方向，推动可持续发展全面融入经营各环节。报告期内，“暖芯行动”深耕公益实践：联合腾讯 SSV 数字平台开展 8 期半导体线上公益课程，持续资助困难学子，落地“润·乐咖啡”助残就业项目，以科教、助学、助弱等举措向社会传递企业温度。

4. 坚守长期主义，提升权威认可

公司 ESG 表现获资本市场及专业机构高度认可。2025 年，公司可持续发展报告首获中国企业社会责任专家委员会“五星级卓越”评价；Wind ESG 评级跃升至“AA 级”，位列半导体行业前列；成功入选央视“央企 ESG 先锋 100”“中国 ESG 上市公司·长三角先锋 50”，获评上市公司协会“可持续发展优秀实践案例”，在中国社科院半导体行业社会责任发展指数中排名第三，并荣膺“中国供应链 ESG 管理示范企业”。

2026 年，公司将深入贯彻 ESG 理念，扎实落实“双碳”战略，推进高质量可持续发展。充分发挥董事会战略与可持续发展委员会统筹引领作用，强化对 ESG 报告、行业对标报告等关键议题审议；健全 ESG 环境管理体系，常态化开展全口径碳数据管控，优化能源消费结构，大力推广光伏、储能等清洁能源应用；持续深化本地化特色 ESG 品牌建设，扎实推进“暖芯行动”公益实践，积极履行社会责任；不断巩固行业权威评价与市场认可，稳步提升 ESG 评级及行业排名。

本公告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能会受到外部经济环境、行业市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。